

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第2区分
 【発行日】平成21年1月8日(2009.1.8)

【公開番号】特開2007-194330(P2007-194330A)
 【公開日】平成19年8月2日(2007.8.2)
 【年通号数】公開・登録公報2007-029
 【出願番号】特願2006-9751(P2006-9751)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/822 (2006.01)
 H 0 1 L 27/04 (2006.01)
 H 0 1 L 21/768 (2006.01)
 H 0 1 L 23/522 (2006.01)
 H 0 1 L 21/3205 (2006.01)
 H 0 1 L 23/52 (2006.01)
 H 0 1 L 21/8247 (2006.01)
 H 0 1 L 27/115 (2006.01)
 H 0 1 L 29/788 (2006.01)
 H 0 1 L 29/792 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 27/04 D
 H 0 1 L 21/90 V
 H 0 1 L 21/88 S
 H 0 1 L 27/04 H
 H 0 1 L 27/10 4 3 4
 H 0 1 L 29/78 3 7 1

【手続補正書】

【提出日】平成20年11月17日(2008.11.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1の配線層と、
 第2の配線層とを備え、

前記第1の配線層および前記第2の配線層の各々は、第1の配線と、前記第1の配線が活性化されていないときに活性化される第2の配線とを含み、

前記第1の配線層および前記第2の配線層の各々において前記第1の配線および前記第2の配線が交互に配置され、

前記第1の配線層および前記第2の配線層の積層方向において、前記第1の配線層に前記第1の配線が配置される場合には前記第2の配線層に前記第2の配線が配置され、前記第1の配線層に前記第2の配線が配置される場合には前記第2の配線層に前記第1の配線が配置される半導体装置。

【請求項2】

前記第1の配線層および前記第2の配線層の少なくともいずれか一方は、前記第1の配線および前記第2の配線間に配置されるシールド配線を含む請求項1記載の半導体装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】

上記課題を解決するために、この発明のある局面に係わる半導体装置は、第1の配線層と、第2の配線層とを備え、第1の配線層および第2の配線層の各々は、第1の配線と、第1の配線が活性化されていないときに活性化される第2の配線とを含み、第1の配線層および第2の配線層の各々において第1の配線および第2の配線が交互に配置され、第1の配線層および第2の配線層の積層方向において、第1の配線層に第1の配線が配置される場合には第2の配線層に第2の配線が配置され、第1の配線層に第2の配線が配置される場合には第2の配線層に第1の配線が配置される。